공동 개발 계약서

(MM/48 m)

경기도 화성시 태안읍 반월리 산16번지에 주사무소를 두고 있는 삼성전자 주식회사 (이하 "삼성전자"라 청함)와 경기도 평택시 지제동 33번지에 주사무소를 두고 있는 아이피에스주식회사 ("아이피에스")은, 2005년 9월 1일 ("계약발효일")부로 다음과 같이 공동개발계약을 체결한다.

제 1 조 (개발목표 및 개발기간)

삼성전자와 아이피에스는 300mm Co-Silicide 공정 대응 목적으로 별첨 1에 명시된 역할 분담 및 일정에 따라 별첨 2의 개발목표를 만족시키는 CVD Chamber를 공동 개발하고자 한다. 본 개발의 기간은 계약발효일부터 12개월(2005년 9월 1일 ~ 2006년 8월 31일)로 하되, 개발기간의 수정이 필요하다고 판단되는 경우 삼성전자와 아이피에스는 서면합의를 통하여 그 기간을 수정할 수 있다.

제 2 조 (개발결과에 대한 보고 및 기술지원)

- (1) 양사는 본 계약기간 중 발생하는 정보 및 개발결과 중 필요한 사항을 상호 공 유하고 평가 및 보완을 요청할 수 있다.
- (2) 양사는 본 개발의 수행을 위하여 상호간 기술정보를 제공하며, 양사는 개발 책임자를 각각 선임하여 개발수행 및 발생 문제점을 해결하기 위하여 기술회의를 소집, 필요한 정보를 교환하도록 한다. 기술회의에 대한 일시, 안건 등 세부사항은 양사 개발책임자가 협의하여 결정한다.

제 3 조 (비밀보장 및 제 3자 협력)

- (1) 양사는 본 계약 내용 및 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 취득한 기술정보를 포함한 비밀 정보를 본 개발의 목적외에 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 본 계약기간 및 종료일로부터 3년간 상대방의 사전 서면동의 없이 제 3자에게 공개할 수 없다.
- (2) 전 항의 의무 위반으로 인하여 입은 일체의 손해는 위반당사자가 상대방에게

배상하여야 한다.



제 4 조 (지적재산권의 귀속)

- (1) 본 계약의 개발 제품과 관련하여 계약기간 중 획득한 지적 재산권에 대해서는 발명자 우선주의에 따라 양사가 각각 독자적으로 개발한 지적재산권은 각 사 독자 소유로 하며 양사가 공동으로 개발한 지적재산권은 공동 소유로 한다.
- (2) 각 사는 본 계약하의 개발결과물에 관련된 독자 소유 지적재산에 대해 상호간에 라이센스가 필요한 경우, 상호 합의 하에 지적재산권을 허여할 수 있다. 지적재산권 허여에 따른 세부 조건은 별도의 계약을 통하여 결정되어진다.

제 5 조 (개발결과물의 구매)

삼성전자는 개발결과물이 제 1조 및 별첨 1, 2에 명시된 개발목표를 달성하고 양산성이 있다고 판단할 경우 아이피에스와 별도로 구매 협의할 수 있으며, 아이피에스는 삼성전자의 구매요구가 있을 경우 본 개발결과물에 대하여 최혜조건으로 삼성전자에게 공급하여야 한다.

제 6 조 (계약 기간 및 계약의 해지)



- (1) 본 계약기간은 제 2항 및 3항에 의해 조기 종료되지 않는 한 제 1조에서 정한 개발 기간과 동일하며 필요시 협의 후 연장 가능하다.
- (2) 양사는 상대방이 본 계약을 중대하게 위반하였을 경우에는 2주 전에 사전 통보하여 본 계약을 해지할 수 있다.
- (3) 양사는 공동개발 수행이 정지되거나 기타 사유로 인하여 소기의 개발성과를 기대하기 극히 곤란하거나 상대방이 공동개발을 완수할 능력이 없다고 인정될 때혹은 개발의 필요성이 없어졌다고 인정될 때, 각 사의 합의 하에 본 계약을 해지할 수 있다.
- (4) 제 2항 및 제 3항에 의하여 본 계약이 해지될 경우, 양사는 해지된 날로부터 20일이내에 해지시까지 상대방으로부터 받은 비밀정보를 모두 반환하거나 파기하여야 한다. 비밀정보를 파기한 경우에는 그 사실을 증명하는 내용을 상대방에게 서면 통보하여야 한다.

제 7 조 (일반 조항)

- (1) 양사는 본 계약의 내용과 별첨의 내용을 서면합의에 의하여 변경할 수 있다.
- (2) 본 계약과 관련하여 해석상 이의가 있을 때에는 양사 합의에 의해 결정하되 소송을 제기할 경우에는 피고의 주소지 관할법원에 하는 것으로 한다.
- (3) 양사는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약 체결 사실 또는 계약 내용에 대해 대외 홍보할 수 없다.
- (4) 본 계약상 양 당사자로서의 지위 및 본 계약 상의 권리의 전부 또는 일부는 상 호 서면합의 없이 제 3자에게 양도할 수 없다.
- (5) 본 계약이 종료되더라도 제3조, 제4조 및 제 5조는 계속 유효하다.
- (6) Specification 수정이 필요시 협의 후 변경 가능하다.

본 계약서는 2부를 작성하여 서명 날인하고 각각 1부씩 보관한다.

30 Mest

별첨1: 역할분담 및 일정

별첨2: 개발목표

삼성전자 주식회사

서명: 사장

성명: Moon Joo-Tal

직위: Vice president

날짜: Oct. 7, 2005

아이피에스 주식회사

서명: 115. CHANS

성명: 강 호등

직위: CZO & President

날짜: 2005,18. 7





별첨 1 . 역할분담 및 일정

1.1 역할분담

	삼성전자	아이피에스
Project Manager	김성태 수석	서태욱 전무
Project Member	이상우 책임 문광진 책임 김현수 선임 이은옥 사원	이기훈 부장 이상훈 부장 백춘금 과장 최형섭 차장

[※] 개발을 수행하기 위하여 발생하는 비용은 상기 역할분담에 따라 각사의 개발부문에 소요되는 비용에 대하여 각사가 부담하기로 한다.





1.2 일정

Item	7	8	9	10	11	12	06/1	2	3	4	5	6	7	8
장비 design														
장비 제작, 입고														
Rev.0 film 특성 평가														
2000 DH Marathon test														
New System Set-up														
Hardware 안전성 평가														
Rev.1 film 특성 평가														
1차 device 적용														1-133





별첨 2. 개발 목표

1. Hardware Specification

	Items	Specification			
	Wafer Size	200mm/ 300mm			
Reactor Access		Backbone			
Transfer Module	Base pressure	< 1E	5-3 Torr		
	Leak Rate	< 2mTorr/min			
	Transfer Arm	Dual Arm			
Cassette Module	AGV	3 (1 port blank-off)			
	Chamber	2			
Loadlock Module	Base pressure	< 1E-3 Torr			
	Leak Rate	< 2m	Torr/min		
	Items	Co Module	Treatment Module		
	Base pressure	< 1E-3 Torr			
Process Module	Process Pump	Dry pump			
Woduic	Pump down time to base	< 1Hr (@r.t.) , < 8Hrs (@process temp.)			
	Temperature uniformity	450°C ± 5°C	700℃ ± 10℃		
Stage heater	Material	Al	Inconel		
	Zone control	dual (1 zone)	dual (2 zone)		
Chamber wall	Temperature uniformity	100℃ ± 10℃	NA		
Chamber wan	Temp. control function	heating	NA		
	Feeding block	2 layer	1 layer		
Shower Head	Temperature uniformity	100℃ ± 10℃	NA		
	Temp. control function	heating	NA		
	Plasma	Remote plasma	RF plasma		
Dogator	Material	Al	Al		
Reactor	Volume	16.85 Liter	19.75 Liter		
	Measurement port	RGA port			







	Items	Co Module	Treatment Module			
	Purge function & Filtration	Ava	ilable			
	Check valve	All gas line				
	Valve function	Solenoid				
	Valve switching time	< 0.2sec				
Gas Delivery	Valve operation number	min. 100,000times (High Temp V/V 50,000)				
	Gas line heating temp.	Max 150℃				
	Gas Supply By MFC	Ar, H2, N2, SiH4	Ar, H2, N2			
	Gas Supply for MO-Cobalt Source	BUBBLER	NA			
	Additional Gas	NF3				
Chamban alaan	In-situ dry cleaning	Optional	NA			
Chamber clean	Wet cleaning period	min 5,000 wfs				
Facilities &	Safety function	Gas leak detector, water leak detector				
Interlock	Interlock	On all necessary items				

2. Process Specification

Items	Specification	Remark			
Deposition rate	> 40	Å/min (Cyclic)			
Deposition rate	1	Å/cycle (ALD)			
RS Uniformity (WIW)	8%	Max-min/2A			
RS Uniformity (WTW)	8%	Max-min/2A			
RS Repeatability(PM to PM)	5%	Max-min/2A			
Thickness uniformity (WIW)	8%	Max-min/2A Max-min/2A Max-min/2A			
Thickness uniformity (WTW)	8%				
Thickness Repeatability(PM to PM)	5%				
Step Coverage	70%	A/R>6, 80nm			
Impurity (Carbon, Oxygen)	C < 5%, O < 2%,	AES			
Resistivity (@100Å)	25	μΩcm			
Film particle	< 30 ea	> 0.16µm			
In-situ Cleaning Period	optional	-			
Throughput (@50Å)	> 15 wfs				
Salicide Rs unif (WIW) @N+/P+	8%	1σ			
Salicide Rs unif (WTW) @N+/P+	8%	1σ			

